

AI 芯片与机柜 · Product Benchmark

公开功率分布：芯片 / 模块 W 与整机柜 kW 分开；TDP、TGP、TBP 和机柜设计口径逐项保留。

● NVIDIA ● AMD ● Microsoft ● Meta ● Intel

芯片 / 加速器 / 模块 · W



机柜 · kW（两种口径分别列）

Designed rack power · 设计功率

GB200 NVL72
● 120 kW [A3/A8]

GB300 NVL72
● 135 kW [A4/A8]

Cabinet TDP · 参考设计

Vera Rubin NVL72 (DSX)
◆ 330 kW [A5/A9]

MGX Gen1.1 (DSX)
◆ 198 kW [A9]

GB200 / GB300：Mission Control 2.3.0 的 designed rack power。MGX / Rubin：DSX 2026-08-19 参考设计 cabinet TDP。两组不连成同口径趋势，均非实测负载或最大 AC 输入。

Google、AWS、华为等缺绝对功率，不填 0。Rubin 单 GPU、Helios 整柜及 Crescent Island 功率未核实，详见 notes。

实心点 = 已公开规格；空心点 = 官方未来计划规格。Meta 明确为 Module TDP，AMD 为 OAM TBP，Maia 为 SoC TDP，不能一律叫单芯片 TDP。图为功率分布，不是 W/cm² 热流密度，也不表示实际平均功耗或产品效率。